

2021-2027年中国IC封测 市场深度评估与投资前景预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国IC封测市场深度评估与投资前景预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202109/239903.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

全球半导体封装测试业整体随着全球半导体产业景气呈现增长态势，市场需求不减，大陆半导体封测产业有望最先受益。在《国家集成电路产业发展纲要》发布之后，国家加快了集成电路产业的布局，封装测试作为集成电路产业链后端关键环节也获得了快速发展，根据《中国半导体封装产业现状与展望》报告显示，2016年我国IC封测市场规模达到1523亿元，大陆半导体封测产业已经处于全球领先地位。2016-2018年全球半导体封测业市场规模（亿美元）

中企顾问网发布的《2021-2027年中国IC封测市场深度评估与投资前景预测报告》共十四章。首先介绍了中国IC封测行业市场发展环境、IC封测整体运行态势等，接着分析了中国IC封测行业市场运行的现状，然后介绍了IC封测市场竞争格局。随后，报告对IC封测做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国IC封测行业发展趋势与投资预测。您若想对IC封测产业有个系统的了解或者想投资中国IC封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 IC封测行业发展综述

1.1 IC封测行业定义及分类

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业产品/服务分类

1.1.3 行业主要商业模式

1.2 IC封测行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 IC封测行业在产业链中的地位

1.2.3 IC封测行业生命周期分析

（1）行业生命周期理论基础

（2）IC封测行业生命周期

1.3 最近3-5年中国IC封测行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 附加值的提升空间

1.3.4 进入壁垒 / 退出机制

1.3.5 风险性

1.3.6 行业周期

1.3.7 竞争激烈程度指标

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析

第二章 IC封测行业运行环境（PEST）分析

2.1 IC封测行业政治法律环境分析

2.1.1 行业管理体制分析

2.1.2 行业主要法律法规

2.1.3 行业相关发展规划

2.2 IC封测行业经济环境分析

2.2.1 国际宏观经济形势分析

2.2.2 国内宏观经济形势分析

2.2.3 产业宏观经济环境分析

2.3 IC封测行业社会环境分析

2.3.1 IC封测产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响

2.3.3 IC封测产业发展对社会发展的影响

2.4 IC封测行业技术环境分析

2.4.1 IC封测技术分析

2.4.2 IC封测技术发展水平

2.4.3 行业主要技术发展趋势

第三章 我国IC封测所属行业运行分析

3.1 我国IC封测行业发展状况分析

3.1.1 我国IC封测行业发展阶段

3.1.2 我国IC封测行业发展总体概况

3.1.3 我国IC封测行业发展特点分析

3.2 2011-2019年IC封测行业发展现状

3.2.1 2011-2019年我国IC封测行业市场规模

3.2.2 2011-2019年我国IC封测行业发展分析

3.2.3 2011-2019年中国IC封测企业发展分析2019年中国大陆十大IC设计企业

1

海思半导体

海思半导体成立于2004年10月，总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。

2

豪威科技

北京豪威是一家注册于北京的有限责任公司(中外合资)。北京豪威的主营业务通过美国豪威开展。美国豪威原为美国纳斯达克上市公司，于2016年初完成私有化并成为北京豪威的全资子公司。

3

紫光展锐

紫光集团于2013年收购展讯通信，2014年收购锐迪科，并于2016年将两者整合为紫光展锐。整合后的紫光展锐致力于移动通信和物联网领域的2G/3G/4G移动通信基带芯片、射频芯片、物联网芯片、电视芯片、图像传感器芯片等核心技术的自主研发。目前在全球设有16个技术研发中心及7个客户支持中心。

4

深圳中兴微电子

中兴微电子由中兴通讯全资控股，其前身是中兴通讯于1996年成立的IC设计部，如今规模已跻身全国IC设计行业前列。

5

华大半导体

华大半导体是中国电子信息产业集团有限公司(CEC)整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团。旗下有三家上市公司，总资产规模超过100亿。2014年5月8日在上海成立，专业从事集成电路设计及相关解决方案。

6

北京智芯微

智芯微成立于2010年，以“用芯让工业更智能”为使命，致力于成为以智能芯片为核心的整体解决方案提供商，是国家高新技术企业，国家规划布局内重点集成电路设计企业，连续五年被评为“中国十大集成电路设计企业”，国家电网公司“国网芯”产业发展的使命担当者。

汇顶科技

汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商，目前主要面向智能移动终端市场提供领先的人机交互和生物识别解决方案，是安卓阵营全球指纹识别方案优秀供应商。与华为、OPPO、vivo、小米、中兴、魅族等知名品牌都有合作。

芯成半导体

芯成半导体有限公司(ISSI)1988年成立，专门设计、开发、销售高性能存储半导体产品，用于Internet存储器件、网络设备、远程通讯和移动通讯设备、计算机外设等。

敦泰电子

敦泰电子于2005年成立，快速发展成为全球领先的人机界面解决方案提供商，致力于为移动电子设备提供极具竞争力的2D/3D触控方案、显示驱动方案、触控显示整合单芯片方案(IDC)、指纹识别方案，销售网络遍布全球，年出货量逾6亿颗，触控芯片出货量连续多年领先业界。

兆易创新

兆易创新成立于2005年4月，是一家以中国为总部的全球化芯片设计公司。公司致力于各类存储器、控制器及周边产品的芯片设计研发。

3.3 区域市场分析

3.3.1 区域市场分布总体情况

3.3.2 2011-2019年重点省市市场分析

3.4 IC封测细分产品/服务市场分析

3.4.1 细分产品/服务特色

3.4.2 2011-2019年细分产品/服务市场规模及增速

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测

3.5 IC封测产品/服务价格分析

3.5.1 2011-2019年IC封测价格走势

3.5.2 影响IC封测价格的关键因素分析

(1) 成本

(2) 供需情况

(3) 关联产品

(4) 其他

3.5.3 2021-2027年IC封测产品/服务价格变化趋势

3.5.4 主要IC封测企业价位及价格策略

第四章 我国IC封测所属行业整体运行指标分析

4.1 2011-2019年中国IC封测所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2011-2019年中国IC封测所属行业运营情况分析

4.2.1 我国IC封测行业营收分析

4.2.2 我国IC封测行业成本分析

4.2.3 我国IC封测行业利润分析

4.3 2011-2019年中国IC封测所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国IC封测所属行业供需形势分析

5.1 IC封测行业供给分析

5.1.1 2011-2019年IC封测行业供给分析

5.1.2 2021-2027年IC封测行业供给变化趋势

5.1.3 IC封测行业区域供给分析

5.2 2011-2019年我国IC封测行业需求情况

5.2.1 IC封测行业需求市场

5.2.2 IC封测行业客户结构

5.2.3 IC封测行业需求的地区差异

5.3 IC封测市场应用及需求预测

5.3.1 IC封测应用市场总体需求分析

(1) IC封测应用市场需求特征

(2) IC封测应用市场需求总规模

5.3.2 2021-2027年IC封测行业领域需求量预测

(1) 2021-2027年IC封测行业领域需求产品/服务功能预测

(2) 2021-2027年IC封测行业领域需求产品/服务市场格局预测

5.3.3 重点行业IC封测产品/服务需求分析预测

第六章 IC封测行业产业结构分析

6.1 IC封测产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国IC封测行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 IC封测产业结构调整方向分析

6.3.5 建议

第七章 我国IC封测行业产业链分析

7.1 IC封测行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 IC封测上游行业分析

7.2.1 IC封测产品成本构成

7.2.2 2011-2019年上游行业发展现状

7.2.3 2021-2027年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对IC封测行业的影响

7.3 IC封测下游行业分析

7.3.1 IC封测下游行业分布

7.3.2 2011-2019年下游行业发展现状

7.3.3 2021-2027年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对IC封测行业的影响

第八章 我国IC封测行业渠道分析及策略

8.1 IC封测行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对IC封测行业的影响

8.1.3 主要IC封测企业渠道策略研究

8.1.4 各区域主要代理商情况

8.2 IC封测行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 IC封测行业营销策略分析

8.3.1 中国IC封测营销概况

8.3.2 IC封测营销策略探讨

8.3.3 IC封测营销发展趋势

第九章 我国IC封测行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 IC封测行业竞争结构分析

(1) 现有企业间竞争

(2) 潜在进入者分析

(3) 替代品威胁分析

(4) 供应商议价能力

(5) 客户议价能力

(6) 竞争结构特点总结

9.1.2 IC封测行业企业间竞争格局分析

9.1.3 IC封测行业集中度分析

9.1.4 IC封测行业SWOT分析

9.2 中国IC封测行业竞争格局综述

9.2.1 IC封测行业竞争概况

(1) 中国IC封测行业竞争格局

(2) IC封测行业未来竞争格局和特点

(3) IC封测市场进入及竞争对手分析

9.2.2 中国IC封测行业竞争力分析

(1) 我国IC封测行业竞争力剖析

(2) 我国IC封测企业市场竞争的优势

(3) 国内IC封测企业竞争能力提升途径

9.2.3 IC封测市场竞争策略分析

第十章 IC封测行业领先企业经营形势分析

10.1 日月光公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 经营状况

10.1.5 发展规划

10.2 艾克尔公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 经营状况

10.2.5 发展规划

10.3 矽品公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 经营状况

10.3.5 发展规划

10.4 星科金朋公司

- 10.4.1 企业概况
- 10.4.2 企业优势分析
- 10.4.3 产品/服务特色
- 10.4.4 经营状况
- 10.4.5 发展规划
- 10.5 力成公司
- 10.5.1 企业概况
- 10.5.2 企业优势分析
- 10.5.3 产品/服务特色
- 10.5.4 经营状况
- 10.5.5 发展规划
- 10.6 长电科技公司
- 10.6.1 企业概况
- 10.6.2 企业优势分析
- 10.6.3 产品/服务特色
- 10.6.4 经营状况
- 10.6.5 发展规划

第十一章 2021-2027年IC封测行业投资前景

- 11.1 2021-2027年IC封测市场发展前景
 - 11.1.1 2021-2027年IC封测市场发展潜力
 - 11.1.2 2021-2027年IC封测市场发展前景展望
 - 11.1.3 2021-2027年IC封测细分行业发展前景分析
- 11.2 2021-2027年IC封测市场发展趋势预测
 - 11.2.1 2021-2027年IC封测行业发展趋势
 - 11.2.2 2021-2027年IC封测市场规模预测
 - 11.2.3 2021-2027年IC封测行业应用趋势预测
 - 11.2.4 2021-2027年细分市场发展趋势预测
- 11.3 2021-2027年中国IC封测行业供需预测
 - 11.3.1 2021-2027年中国IC封测行业供给预测
 - 11.3.2 2021-2027年中国IC封测行业需求预测
 - 11.3.3 2021-2027年中国IC封测供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2021-2027年IC封测行业投资机会与风险

12.1 IC封测行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2021-2027年IC封测行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2021-2027年IC封测行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 IC封测行业投资战略研究

13.1 IC封测行业发展战略研究

13.1.1 战略综合规划

13.1.2 技术开发战略

13.1.3 业务组合战略

13.1.4 区域战略规划

13.1.5 产业战略规划

- 13.1.6 营销品牌战略
- 13.1.7 竞争战略规划
- 13.2 对我国IC封测品牌的战略思考
 - 13.2.1 IC封测品牌的重要性
 - 13.2.2 IC封测实施品牌战略的意义
 - 13.2.3 IC封测企业品牌的现状分析
 - 13.2.4 我国IC封测企业的品牌战略
 - 13.2.5 IC封测品牌战略管理的策略
- 13.3 IC封测经营策略分析
 - 13.3.1 IC封测市场细分策略
 - 13.3.2 IC封测市场创新策略
 - 13.3.3 品牌定位与品类规划
 - 13.3.4 IC封测新产品差异化战略
- 13.4 IC封测行业投资战略研究
 - 13.4.1 2019年IC封测行业投资战略
 - 13.4.2 2021-2027年IC封测行业投资战略
 - 13.4.3 2021-2027年细分行业投资战略

第十四章 研究结论及投资建议

- 14.1 IC封测行业研究结论
- 14.2 IC封测行业投资价值评估
- 14.3 IC封测行业投资建议
 - 14.3.1 行业发展策略建议
 - 14.3.2 行业投资方向建议
 - 14.3.3 行业投资方式建议

图表目录：

- 图表1：IC封测行业生命周期
- 图表2：IC封测行业产业链结构
- 图表3：2011-2019年全球IC封测行业市场规模
- 图表4：2011-2019年中国IC封测行业市场规模
- 图表5：2011-2019年IC封测行业重要数据指标比较

图表6：2011-2019年中国IC封测市场占全球份额比较

图表7：2011-2019年IC封测行业工业总产值

图表8：2011-2019年IC封测行业销售收入

图表9：2011-2019年IC封测行业利润总额

图表10：2011-2019年IC封测行业资产总计

图表11：2011-2019年IC封测行业负债总计

图表12：2011-2019年IC封测行业竞争力分析

图表13：2011-2019年IC封测市场价格走势

图表14：2011-2019年IC封测行业主营业务收入

图表15：2011-2019年IC封测行业主营业务成本

图表16：2011-2019年IC封测行业销售费用分析

图表17：2011-2019年IC封测行业管理费用分析

图表18：2011-2019年IC封测行业财务费用分析

图表19：2011-2019年IC封测行业销售毛利率分析

图表20：2011-2019年IC封测行业销售利润率分析

图表21：2011-2019年IC封测行业成本费用利润率分析

图表22：2011-2019年IC封测行业总资产利润率分析

图表23：2011-2019年IC封测行业集中度

图表24：2021-2027年中国IC封测行业供给预测

图表25：2021-2027年中国IC封测行业需求预测

图表26：2021-2027年中国IC封测行业市场容量预测

更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202109/239903.html>